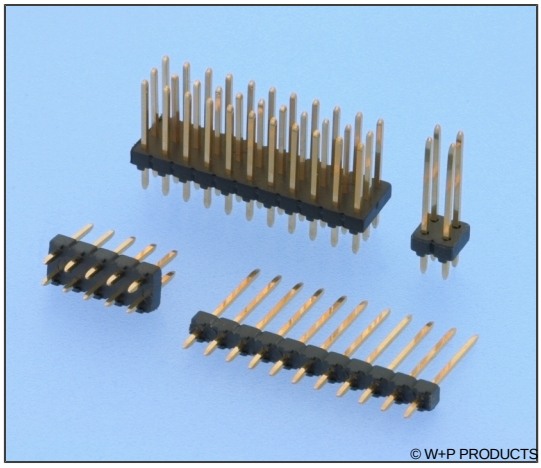
143 / 144 / 145

Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig

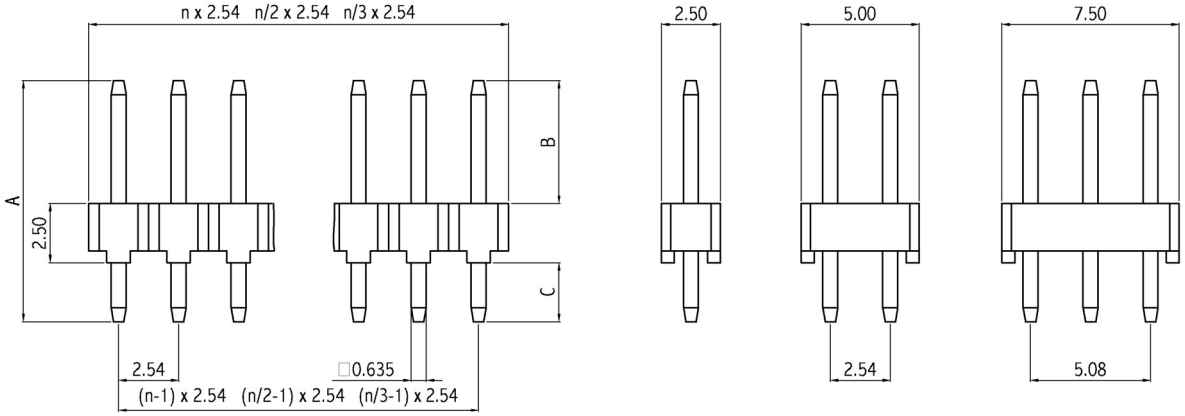
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	*0.635mm square pin, copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*none*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Withstanding Voltage	*1 kV DC*
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	*250 V AC*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 340 348 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*	***Dimensions****	***Contacts****	***Plating****
143	**12**	**010**	**00**
Thermisch gerissene Kontakte *Electro-strictioned contacts* **143** Einreihig *Single row* **144** Zweireihig *Double row* **145** Dreireihig *Triple row*	**11** A=10,80 B=5,80 C=2,50mm **12** A=11,30 B=5,50 C=3,30mm **13** A=12,60 B=6,80 C=3,30mm **14** A=13,90 B=8,10 C=3,30mm **15** A=14,70 B=8,90 C=3,30mm **16** A=17,70 B=11,90 C=3,30mm **17** A=19,80 B=14,00 C=3,30mm **18** A=21,60 B=15,80 C=3,30mm **19** A=22,80 B=17,00 C=3,30mm **20** A=24,90 B=19,10 C=3,30mm **A/B/C** Gesamtlänge & Wunschmaße *Total length & Dimensions*	**001-050** Einreihig *Single row* **004-100** Zweireihig *Double row* **009-120** Dreireihig *Triple row*	**00** Au flash **10** Au 0,25µm **30** Au 0,75µm **50** Sn Au flash min. 0,1µm *Au flash min. 0,1µm* Weitere Veredelungen auf Anfrage *More plating options on request*

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage. Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn. Informationen.

We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more dimensions on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.

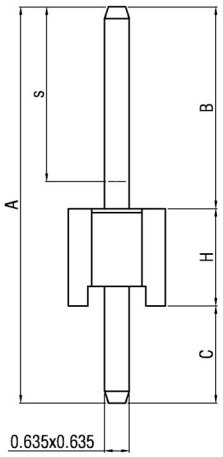
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Downloaded from Arrow.com.

Gerade Stiftleisten

A : Gesamtstiftlänge
B : Länge Steckseite
C : Länge Lötseite
H : Höhe Isolierkörper
s : Bereich der sel. Veredelung

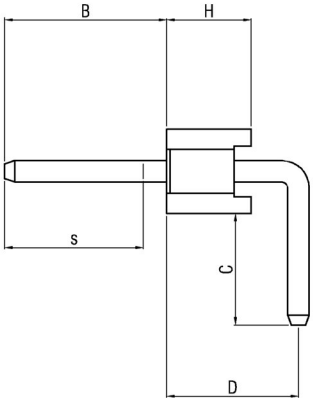
Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



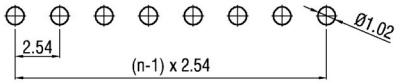
Gewinkelte Stiftleisten

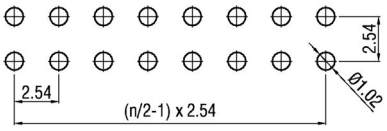
B : Länge Steckseite
C : Länge Lötseite
D : Abstand zu Steckseite
H : Höhe Isolierkörper
s : Bereich der sel. Veredelung

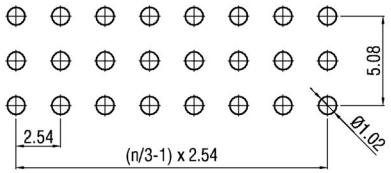
Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



PCB Layouts





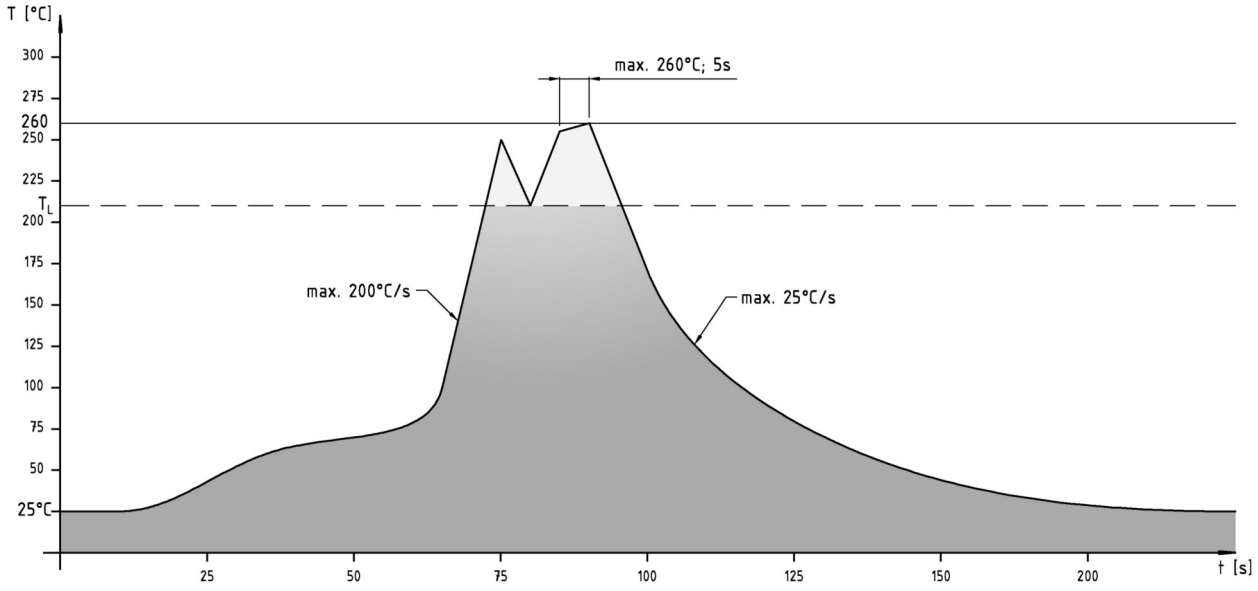


Downloaded from Arrow.com.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Downloaded from Arrow.com.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

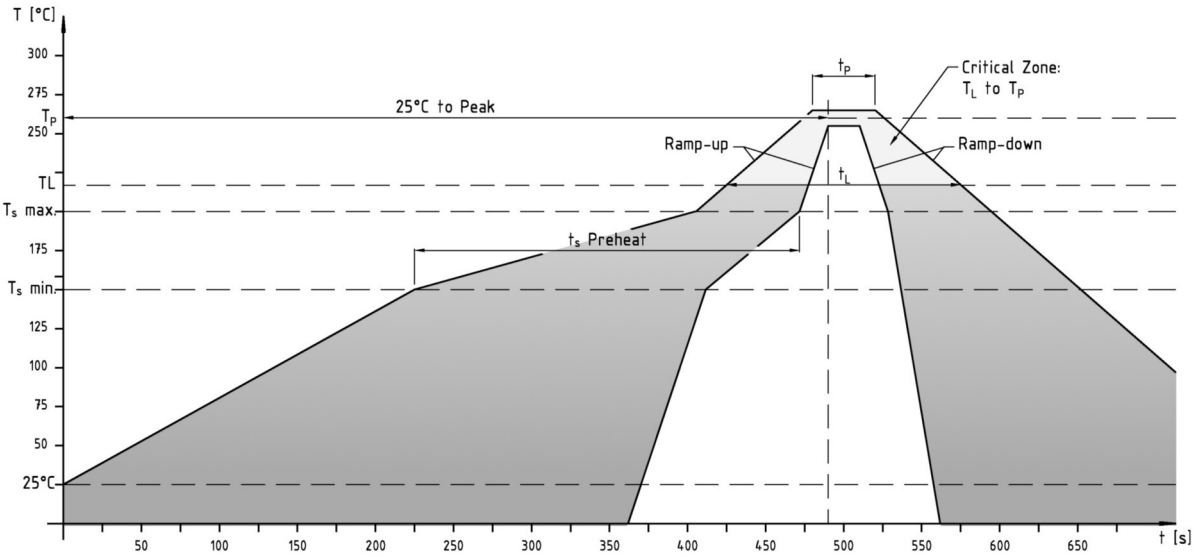
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*



Downloaded from Arrow.com.